# DIODE MODULE (non-isolated)

# DAF160AA

#### DAF160AA

#### ⟨Features & Advantages⟩

- Anode common 2 in 1Diode Module
- Non-isolated package
- EU RoHS compliant

#### ⟨Applications⟩

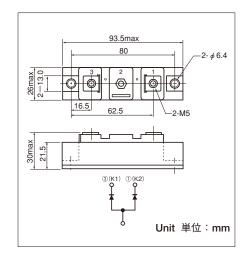
- Engine starter circuit (ex. Gas engine heatpump air-conditioner)
- Battery charger
- Switching mode power supplies

#### 〈特長〉

- アノードコモン 2in1ダイオードモジュール
- 非絶縁型 パッケージ採用
- 欧州RoHS指令適合

#### 〈用途〉

- エンジンスターター回路(例:ガスエンジン・ヒートポンプ・エアコン)
- 充電器
- 各種電源装置



### ■Maximum Ratings 最大定格

(Unless otherwise specified Tj=25℃/特にことわらない限りTj=25℃)

Symbol 記号	Item 項 目	Ratings 定格值	Unit 単位
VRRM	Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク繰返し逆電圧	400	V
VRSM	Non-Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク非繰返し逆電圧	480	V

Symbol 記号	Item	項目	Conditions 条件	Ratings 定格值	Unit 単位
lf(AV)	Average Forward 定格平均順電流	Current	Single phase half wave, 180° conduction Tc=90℃ 単相半波平均值,180°導通角 Tc=90℃	160	А
IF(RMS)	R.M.S. Forward C 定格実効順電流	urrent	Single phase half wave, 180° conduction Tc=90℃ 単相半波実効値,180°導通角 Tc=90℃	250	А
IFSM	Surge Forward Cu 定格サージ順電流	ırrent	1/2cycle, 50/60Hz, Peak value, non-repetitive 50/60Hz 正弦半波, 1サイクル, 波高値, 非繰返し	2900/3200	А
l²t	l <sup>2</sup> t 電流二乗時間積		Value for one cycle of surge current 1 サイクルサージ順電流に対する値	42600	A <sup>2</sup> s
Tj	Operating Junctio 定格接合部温度	n Temperature		-40~+150	°C
Tstg	Storage Temperature 保存温度			-40~+125	℃
	Mounting Force 締付トルク	Mounting (M6) 取付(M6)	Recommended Value 2.5~3.9(25~40) 推奨値	4.7 (48)	N∙m
		Terminal(M5) 端子(M5)	Recommended Value 1.5~2.5(15~25) 推奨値	2.7 (28)	(kgf·cm)
	Mass 質量		Typical Value 標準值	140	g

## ■Electrical Characteristics 電気的特性

(Unless otherwise specified Tj=25℃/特にことわらない限りTj=25℃)

,,,,,,,								
Symbol	Item	Conditions	Ratings 規格値			Unit		
記号	項目	条 件	Min.	Тур.	Max.	単位		
IRRM	Repetitive Peak Reverse Current 逆電流	Tj=150°C, V <sub>R</sub> =V <sub>RRM</sub>			30	mA		
VFM	Forward Voltage Drop 順電圧降下	Forward current 500A, Inst. measurement 電流波高值 500A 瞬時測定		1.17	1.30	V		
VT(TO)	Threshold Voltage スレッショルド電圧	Tj=150°C			0.90	V		
rt	Slope Resistance スロープ抵抗	Tj=150°C			0.66	mΩ		
Rth(j-c)	Thermal Impedance 熱抵抗	Junction to case 接合部―ケース間(½モジュール)			0.29	°C/W		
Rth(c-f)	Interface Thermal Impedance 接触熱抵抗	Case to Heat sink Thermal Conductivity (Silicon grease) ≒7×10³ [W/cm・℃] ケース─フィン間(1 モジュール), グリス塗布(グリス熱伝導率 :7×10³ [W/cm・℃]		0.04		°C/W		

